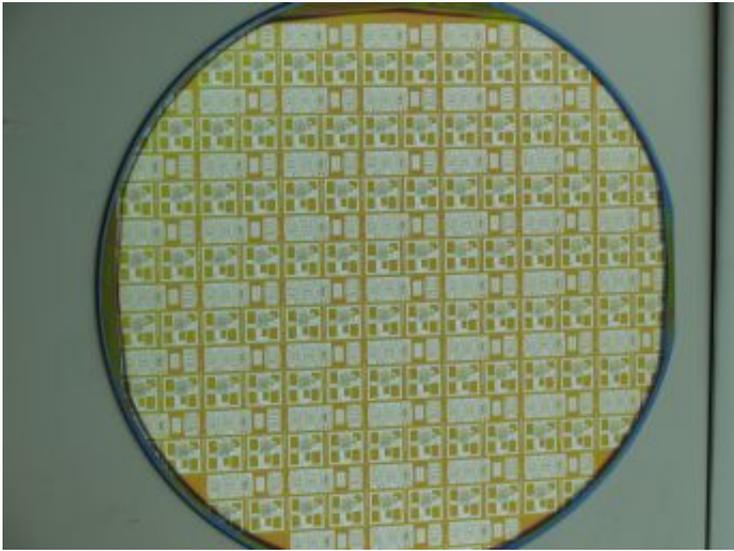
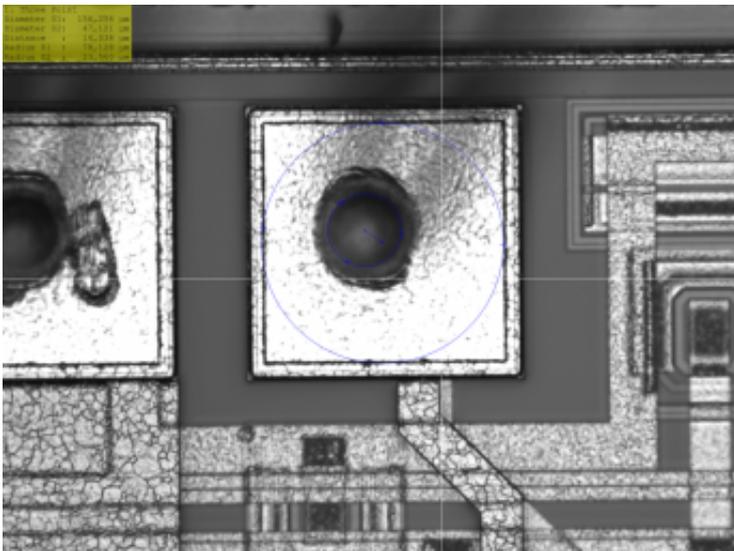


Makro-Inspektion



Makro-Inspektion und Dokumentation: Das Waferhandlingsystem ist mit verschiedenen anwählbaren Lichtquellen ausgestattet. Dazu gehört die homogene Leuchtfeldplatte für eine Hellfeldinspektion sowie eine Dunkelfeld-Lichtquelle zur Inspektion auf Partikel, Kratzer u.s.w..

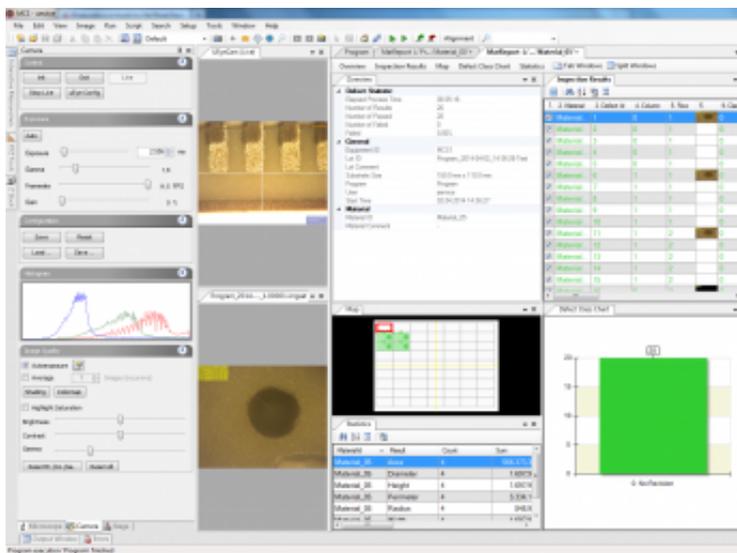
3D-Bondinspektion



Prüfung von Wedgebonds und Ballbonds mit 3D Mikroskopie.

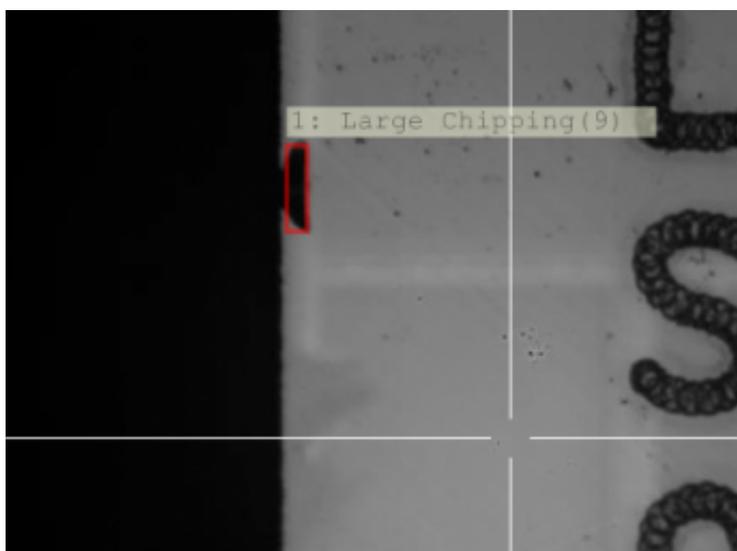
Weißlichtinterferometrie und Konfokale Mikroskopie in Verbindung mit speziellen Softwaremodulen.

Siebdruck-Kontrolle



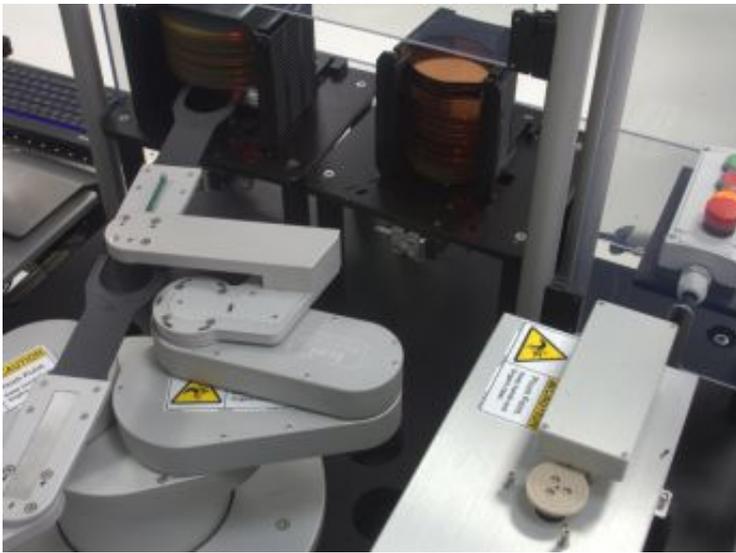
AOI-Kontrolle des Druckbildes gegen importierte CAD Daten.

Chipping Inspektion



Beispiel einer Chipping Prüfung mittels Infrarotkamera.

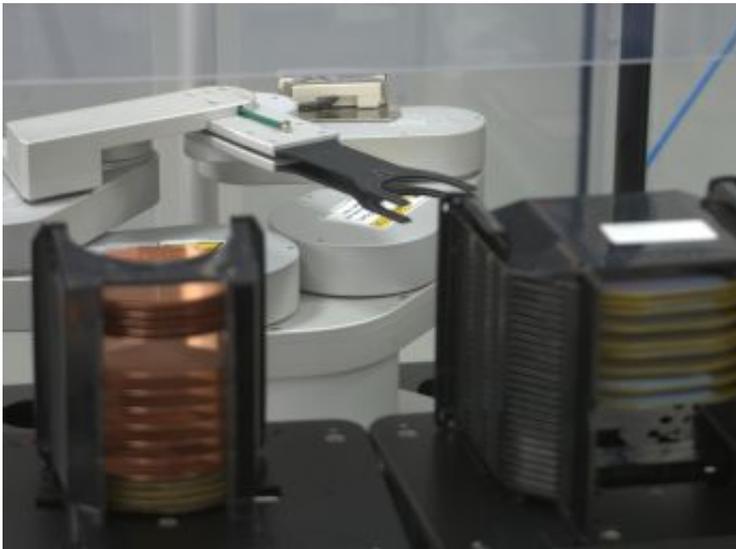
Wafer Handling



Roboter und Prealigner nach Anforderung, dazu wählbares Zubehör für:

- Vacuum backside handling
- Vacuum edge handling

Vakuum-Greiftechnik

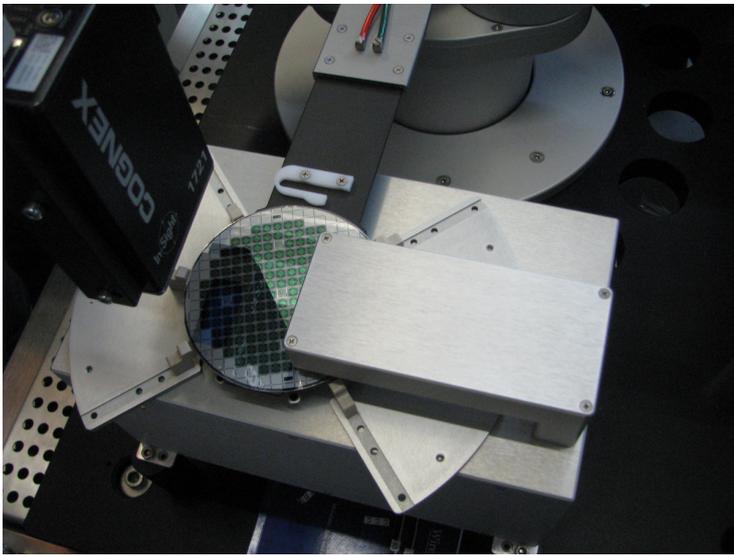


Zur Lösung verschiedenster Mess- und Inspektionsaufgaben greift Promicron auf eine Vielzahl unterschiedlicher [optischer Verfahren](#) zurück und kombiniert diese je nach Anforderung und Kundenwunsch.

Randgreiftechnik

—

Die Randgreifvorrichtung nimmt ein Substrat auf (z.B. einen Wafer) und lässt es wieder los. Zur Lösung verschiedenster Mess- und Inspektionsaufgaben greift Promicron auf eine Vielzahl an unterschiedlichen optischen Verfahren zurück und kombiniert diese je nach Anforderung und Kundenwunsch.

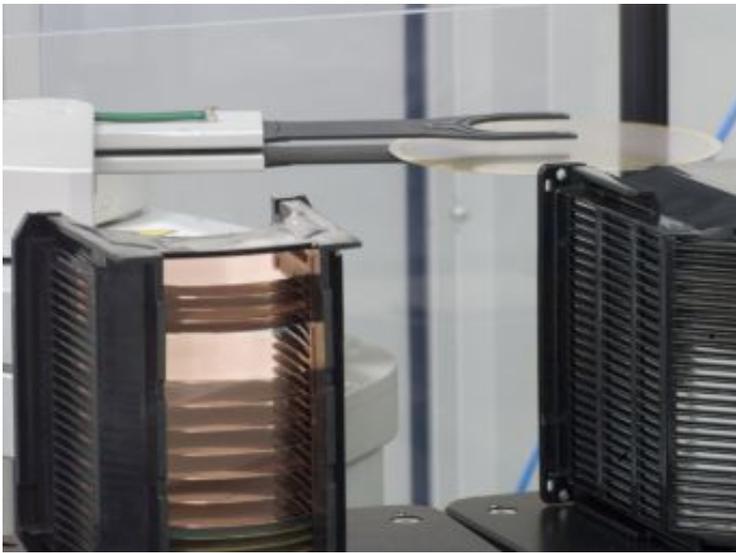


Gebondete Wafer



Gebondete Wafer sind erheblich dicker als Einzelwafer und können einen Versatz aufweisen. Sie können zudem unrund sein. Zur Lösung verschiedenster Mess- und Inspektionsaufgaben greift Promicron auf eine Vielzahl unterschiedlicher optischer Verfahren zurück und kombiniert diese je nach Anforderung und Kundenwunsch.

Bow & Warp Wafer



Promicon bietet erprobte Lösungen, um auch für Wafer mit deutlichem Bow / Warp ein sicheres Handling zu gewährleisten.

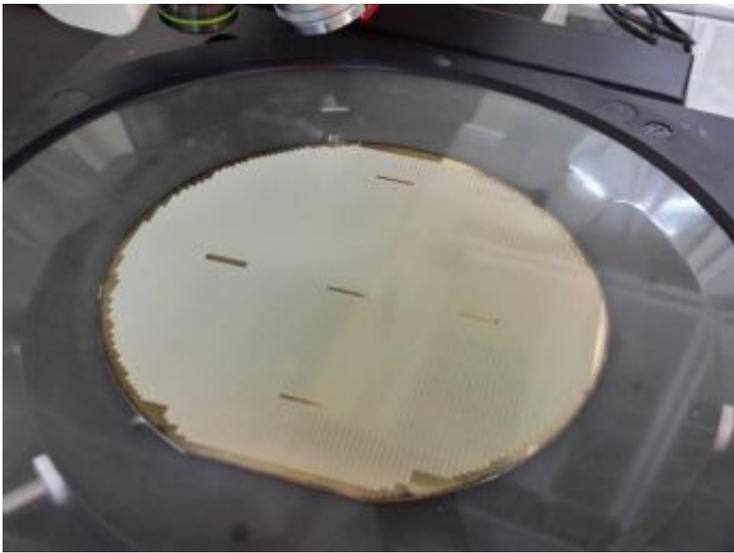
Mit den entsprechenden Soft- / Hardwaremodulen ist auch die Messung und grafische Darstellung des Bow / Warp Wafers möglich.

Wafer-Chuck



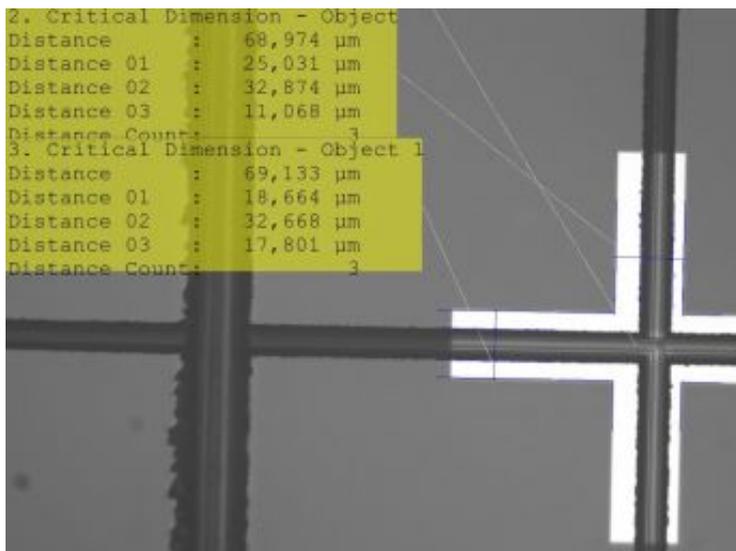
Promicon greift auf unterschiedliche Verfahren (z.B. Friktion oder Vakuüm) zurück und adaptiert diese je nach Anforderung und Kundenwunsch.

Wafer auf Tape



Vakuum Chucks mit feinstporöser Oberfläche für gesägte Wafer auf Blue Tape. Auch Wafer mit sehr kleinen Dies werden sicher und eben angesaugt.

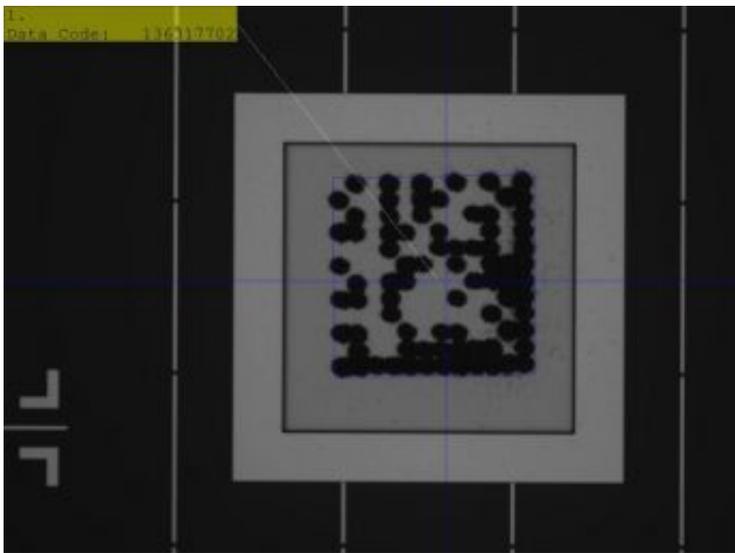
Wafer-Dicing Inspektion



Inspektion und messtechnische Kontrolle der Sägestraßen (dicing line) auf

- Versatzfehler bzw. Alignmentfehler
- Sägetiefe
- Chipping

Lesen von QR Codes



QR Codes und Barcodes oder Klarschrift können mit extern adaptierten Lesegeräten (Code Reader) oder ggfs. auch im Mikroskop-Kamerabild automatisch gelesen werden.

Maskeninspektion



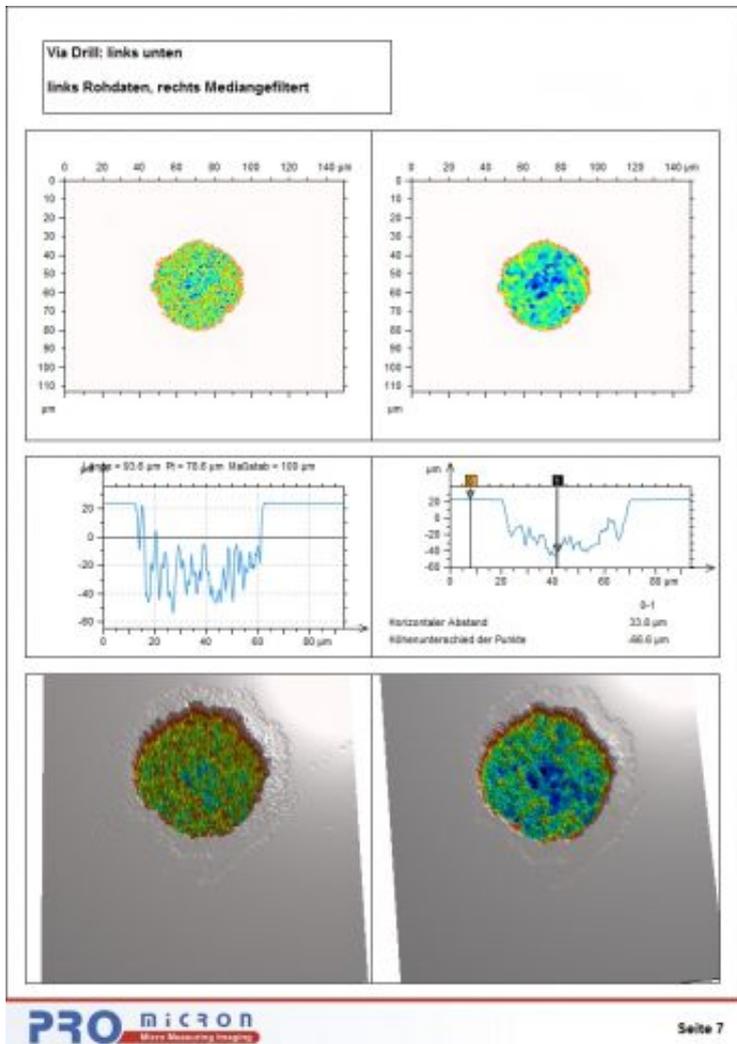
Inspektion von Masken, die zur Erzeugung von Wafern eingesetzt werden.

Aufgabe der Inspektion ist die Erkennung von zufälligen Fehlern (Kratzer, Partikel) und systematischen Fehlern / Strukturfehlern.

Chrom auf Glas Substrate werden meist im Durchlicht inspiziert - auch Auflicht und Dunkelfeld ist anwendbar.

Im Rahmen der **Messung** können zudem Qualitätsparameter bestehender Masken (z.B. Verschleiß) überprüft werden.

3D VIA Prüfung



Prüfung von VIA's mit 3D Mikroskopie: Weißlichtinterferometrie und Konfokale Mikroskopie in Verbindung mit speziellen Softwaremodulen.